논문 2015-52-7-5

# SU-8 패시베이션을 이용한 솔루션 IZO-TFT의안정성 향상에 대한 연구

# (Stability Enhancement of IZOthin Film Transistor Using SU-8 Passivation Layer)

김 상 조\*, 이 문 석\*\*

(Sang-Jo Kim and Moonsuk Yi<sup>©</sup>)

#### 요 약

본 연구에서는 SU-8을 절연층으로 사용해 솔루션 공정을 바탕으로 하여 Indium Zinc Oxide(IZO) thin film transistor(TFT)의 안정성을 향상에 대해 연구하였다. 매우 점성이 강하며 negative lithography 용으로 사용되는 SU-8은 기계 적, 화학적으로 높은 안정도를 가진다. 그리고 이 SU-8을 사용해 TFT층의 위에 스핀코팅을 사용해 절연막 층을 쌓고 photo lithography를 이용해 patterning을 하였다. SU-8층에 의한 positive bias stress(PBS)에 대한 전기적 특성 향상의 이유를 연구 하기 위해 TFT에 X-ray photoelectron spectroscopy(XPS), Fourier transform infrared spectroscopy(FTIR) 분석을 시행하였 다. SU-8을 절연층으로 한 TFT는 좋은 전기적 특성을 보였으며, 전류점멸비, 전자이동도, 문턱전압, subthreshold swing이 각 각 10<sup>6</sup>, 6.43cm<sup>2</sup>/V·s, 7.1V, 0.88V/dec로 측정되었다. 그리고 3600초 동안 PBS를 가할 시 ΔV<sub>th</sub>는 3.6V로 측정되었다. 그러나 SU-8 층이 없는 경우 ΔV<sub>th</sub>는 7.7V 였다. XPS와 FTIR을 분석한 결과, SU-8 절연층이 TFT의 산소의 홉/탈착을 차단하는 특 성에 의해 PBS에 강한 특성을 나타나게 함을 확인하였다.

#### Abstract

In this work, SU-8 passivated IZO thin-film transistors(TFTs) made by solution-processes was investigated for enhancing stability of indium zinc oxide(IZO) TFT. A very viscous negative photoresist SU-8, which has high mechanical and chemical stability, was deposited by spin coating and patterned on top of TFT by photo lithography. To investigate the enhanced electrical performances by using SU-8 passivation layer, the TFT devices were analyzed by X-ray photoelectron spectroscopy(XPS) and Fourier transform infrared spectroscopy(FTIR). The TFTs with SU-8 passivation layer show good electrical characterestics, such as  $\mu_{FE}$ =6.43cm<sup>2</sup>/V·s, V<sub>th</sub>=7.1V,  $I_{on/off}$ =10<sup>6</sup>, SS=0.88V/dec, and especially 3.6V of  $\Delta$  V<sub>th</sub> under positive bias stress (PBS) for 3600s. On the other hand, without SU-8 passivation,  $\Delta V_{th}$  was 7.7V. XPS and FTIR analyses results showed that SU-8 passivation layer prevents the oxygen desorption/adsorption processes significantly, and this feature makes the effectiveness of SU-8 passivation layer for PBS.

Keywords: SU-8, passivation, solution-process, oxide-TFT, PBS

\*\* 정회원, 부산대학교 전자공학과

© Corresponding Author(E-mail: msyi@pusan.ac.kr)

<sup>\*</sup> 학생회원, 부산대학교 전자전기컴퓨터공학과

<sup>(</sup>Department of Electrical and Computer Engineering, Pusan National University)

<sup>(</sup>Department of Electronic Engineering, Pusan National University)

<sup>※</sup> 본 논문은 BK21플러스 IT기반 융합산업 창의인력양성사업단에 의하여 지원되었음.

Received ; December 6, 2014 Revised ; March 18, 2015 Accepted ; July 7, 2015

### I.서 론

비정질 Si TFT의 경우 낮은 전기적 특성으로 인해 상용화에 많은 제약을 받아 대안으로써 다른 물질이 연 구되고 있으며 그 중 산화물 반도체가 새로운 평판 디 스플에이의 backplane 물질로 주목을 받고 있다. 산화 물 반도체의 경우 비정질 상태에서 높은 이동도와 투과 성, 낮은 누설전류와 다양한 공정을 사용해 제작가능하 다.<sup>[1]</sup> 박막을 쌓기 위한 공정으로 pulsed laser deposition(PLD)<sup>[2]</sup>, 스퍼터링<sup>[3]</sup>과 같은 진공공정과 잉크 젯 프린팅<sup>[4~6]</sup>, roll-to-roll 공정<sup>[7]</sup> 등의 솔루션 공정이 있다. 솔루션 공정으로 제작된 비정질 산화물 반도체를 기반으로 한 TFT 중 IZO, ZTO, IGO 그리고 IGZO 등 이 연구되고 있다<sup>[8~11]</sup>. 솔루션 공정은 많은 장점을 가 지고 있다. 단순하고 낮은 비용의 공정일 뿐만 아니라, 균질성과 조성을 조절할 수 있으며 생산성 또한 우수하 다.[1] 그러나 산화물 반도체는 외부 환경의 수분과 산소 의 흡/탈착, 제작과정에서의 back channel의 손상 및 bias stress에 대한 불안정성을 가지고 있다.<sup>[12]</sup> Lee 등 (2009)<sup>[13]</sup>은 수분이 shallow donor로 작용 및 전자의 트 랩으로 작용하는 결점이 되어 Negative Bias Thermal Illumination(NBTI)에 영향을 줌을 밝혔고, Park 등 (2008)<sup>[14]</sup>은 절연층이 없는 back channel에 흡착된 수분 에 의한 효과를 설명하였다. 그리고 back channel에 흡 착된 산소는 electron acceptor로 작용하여 Vth가 양의 방향으로 이끔을 보였다.

이미 몇몇의 그룹에 의해 SiO<sub>x</sub><sup>[15]</sup>, TiO<sub>x</sub><sup>[16]</sup>,SiN<sub>x</sub><sup>[17]</sup> 그 리고 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub><sup>[18]</sup> 등의 물질이 절연막으로 사용되었다. 이 러한 절연막 물질들은 위에서 언급한 안정성의 감소 요 인을 차단함으로써 positive 그리고 negative bias stress에 대한 불안정성의 감소에 효과적인 모습을 보 였다. 그러나 언급한 절연막 물질들은 진공공정에 의해 증착된다. 또한 진공증착한 IGZO를 활성층으로 사용한 TFT소자의 bias stability를 증가시키기 위하여 SU-8 포토레지스터를 패시베이션 층으로 활용한 연구도 보고 되어지고 있다.<sup>[19]</sup>

본 연구에서는 spin-coating으로 입힌 SU-8층을, solution 공정을 적용한 IZO TFT에 패시베이션 층으로 사용하여 전기적 특성을 개선하고 안정성을 향상시킨 소자를 제작하였다.

#### Ⅱ. 실험방법

SU-8을 증착한 TFT소자는 총 5단계에 의해 제작되 었다. 채널층으로 사용할 IZO의 제작을 위해 indium nitrate hydrate와 zinc acetate dihydrate 금속 전구체를 사용하였다. 용매로는 2-methoxyethanol을 사용하였고 안정제로 monoethanolamine을 사용하였다. 이 산화물 용액은 1시간 동안 60℃로 섞었다. TFT 소자는 그림 1. 과 같이 bottom-gate inverted staggered TFT로 제작 되었다. n-type으로 도핑된 실리콘 웨이퍼를 기판 및 게이트로 사용하였고 게이트 절연막으로 SiO2를 PECVD를 이용해 2000Å 두께로 증착하였다. 채널층으 로 IZO 용액을 spin-coating을 이용해 증착 후 450℃로 1시간 동안 가열하였다. source와 drain 전극으로 알루 미늄을 e-beam evaporator를 이용해 100nm 증착하였 다(1단계). TFT 소자를 제작한 후 1시간동안 200℃로 핫플레이트 위에서 post annealing을 하였다(2단계). IZO 용액에서 In:Zn의 조성비는 1:1로 사용하였다. 절연 막으로 SU-8을 사용하였는데, 절연막 층은 소자의 가 장 윗부분에 증착되었다. SU-8은 spin-coating 법을 사 용해 증착되었고(5000rpm으로 약 10um 두께로 증착됨) 핫플레이트 위에서 65℃로 5분, 95℃로 5분 동안 softbake를 하였다. 그 후 shadow mask를 이용해 패널 부분을 mask aligner를 이용해 5초 동안 UV를 조사한 후 Postexposure bake를 핫플레이트 위에서 95℃에서 5 분간 가열하였다. 그 후 SU-8 developer에 2분 30초간 develop을 한 후 isopropanol(IPA)에 담궈 씻어내었다. 그 다음 65℃에 5분, 95℃에 30분 간 hard baking을 하 였다(3단계). SU-8을 증착 한 후 200℃에 1시간 동안 핫플레이트 위에 가열을 한 후(4단계) 마지막으로 다시



그림 1. 실험에 사용된 oxide-TFT의 구조

Fig. 1. Schematic of oxide-TFT structure used for experiment.

1시간 동안 핫플레이트 위에서 가열하였다(5단계). 3단 계와 4단계, 5단계에서 SU-8의 변화를 알기 위해 Fourier transform infrared(FTIR) 분석을 하였고, TFT 의 전기적 특성변화를 알기 위해 X-ray photoelectron spectroscopy(XPS)를 시행하였다.

#### Ⅲ. 결과 및 토의

그림 2.는 각 단계에 따른 TFT의 V<sub>G</sub>-I<sub>D</sub> 특성의 변화 에 대해서 나타내었다. 그림 2.에서 볼 때 1단계에서는 IZO의 높은 carrier concentration에 의해 Ion/off비가 8\*10<sup>3</sup>, 이동도는 7.11[cm<sup>2</sup>/V·s]임을 확인할 수 있다.





Fig. 2. Transfer characteristic curce of IZO TFT with different stage.



그림 3. IZO 위 층에 있는 SU-8 박막의 FTIR 흡수 스 펙트럼

Fig. 3. FTIR adsorption spectra of SU-8 films on top of IZO.

post annealing을 통한 2단계에서 carrier concentration 의 변화로 인해 Ion의 감소로 이동도가 6.25cm<sup>2</sup>/V·s로 감소가 있으나 Ioff가 크게 감소해 Ion/off가 10<sup>7</sup> 이상으 로 크게 향상됨을 알 수 있다. 그러나 그림.5와 같이 PBS에 대한 안정성은 나빠졌다.<sup>[19]</sup> SU-8을 증착한 3단 계에서는 SU-8과 IZO 채널층 계면에서 새로운 상태변 화가 발생하여 반도체적 특성을 띠지 않았다.<sup>[19]</sup> SU-8 을 증착 후 Vth가 음의 방향으로 이동한 것과 Ion이 증 가한 것으로 보아 SU-8을 증착하면서 TFT 채널층이 산소와 흡착을 하여 carrier concentration이 증가한 것 으로 예상된다.<sup>[20~21]</sup> 그리고 SU-8 내의 유기성분이 가 지고 있는 수분과 수소가 carrier concentration의 증가 에 관여하였을 것이다.<sup>[19]</sup> SU-8을 증착한 후(3단계)와 200℃로 가열을 한 후(4단계) SU-8 내의 구조변화를 알기 위해 FTIR spectroscopy를 시행하였다. 915cm<sup>-1</sup> 의 peak는 epoxy ring vibration에 해당하는데 이것은 중합도에 의한 저항을 평가하는데 사용된다.[22~23] 3단 계에서는 아직 cross linking이 완료되지 않아 epoxy ring이 관측되나 hard baking을 한 4단계에서는 cross-linking이 촉진되어 큰 polymer network를 형성 하게 된다. 그림 3.에서 FTIR에서 915cm<sup>-1</sup>의 변화는 사 용되지 않은 epoxy ring의 감소에 의해 완전히 cross-linking이 완료됨을 나타낸다. 그림 2.에서 3단계 에서 4단계로는 Vth가 양의 방향으로 이동하고 Ioff가 감소하였는데 이것은 IZO 내부의 전자가 SU-8에 의해 capture되고 SU-8 내부의 negative charge에 의한 현 상으로 보인다.[19]

그림 4.는 IZO-TFT 채널층의 XPS O1s 그래프이다. 529.9와 531.4 eV는 oxide 격자 안에 있는 산소의 oxygen vacancies가 없을 때와 있을 때의 binding energy이며 532.4 eV는 hydroxide 내의 산소에 할당된 binding energy이다.<sup>[24]</sup>oxygen vacancy가 많을 때

- 표 1. IZO TFT의 3단계, 4단계, 5단계에서의 M-O, Vo"(oxygen vacancy), M-OH Areal ratio
- Table 1. M-O, Vo", M-OH Areal ratio in 3, 4, 5 stage of IZO TFT.

|     | Areal ratio |       |       |  |  |  |
|-----|-------------|-------|-------|--|--|--|
|     | M-O         | Vo"   | M-OH  |  |  |  |
| 3단계 | 4.92        | 51.96 | 43.10 |  |  |  |
| 4단계 | 6.64        | 50.18 | 43.16 |  |  |  |
| 5단계 | 5.62        | 40.42 | 53.94 |  |  |  |



- 그림 4. (a) 3단계 (b) 4단계 (c) 5단계 IZO TFT의 O1s spectra
- Fig. 4. O1s spectra for (a) stage 3 (b) stage 4 (c) stage 5 IZo TFT.

carrier concentration이 증가하는데<sup>[25]</sup> 4단계에서의 oxygen vacancy보다 5단계에서 oxygen vacancy의 감 소로 carrier concentration이 줄어듦으로써 그림 2.와 같이 V<sub>th</sub>가 -4.9V에서 7.2V로 양의 방향으로 이동하며, Ion이 감소하였지만 Ioff가 큰 폭으로 감소하여 Ion/off 비가 증가하였음을 확인할 수 있다. 그림 5.에서와 같이 SU-8을 절연막을 쌓고 가열을 한 후(5단계) PBS에 대 해 강한 안정성을 확인할 수 있다.



- 그림 5. (a) 1 단계 (b) 2 단계 (c) 5 단계에서 PBS를 걸 어 주었을 때의 V<sub>G</sub>-I<sub>D</sub> 특성 곡선
- Fig. 5.  $I_D-V_G$  Transfer curve of (a) 1<sup>st</sup> stage (b) 2<sup>nd</sup> stage (c) 5<sup>th</sup> stage IZO TFT as function of PBS time.

|     | 0s  | 600s | 1200s | 1800s | 2400s | 3000s | 3600s | ΔVth(V) |
|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 1단계 | 6.6 | 9    | 10.4  | 11.4  | 12.6  | 13.6  | 14.3  | 7.7     |
| 2단계 | 6.7 | 11.4 | 14.4  | 14.4  | 16.6  | 18.4  | 19.2  | 12.5    |
| 5단계 | 7.2 | 9.6  | 10.3  | 10.4  | 10.5  | 10.7  | 10.8  | 3.6     |

- 표 2. PBS를 걸어 줄 때 시간에 따른 Vm의 변화
- Table 2. Variation of  $V_{\text{th}}$  by time when biasing PBS on TFT.

TFT를 증착하고 난 뒤 PBS를 3600s 동안 가했을 때,
ΔV<sub>th</sub>가 3.6V로 눈에 띄게 줄어듬을 확인할 수 있다. 이것
은 가열 후 조밀해진 SU-8이 IZO의 채널층에서 외부 산

36

소와의 흡/탈착을 막아주기 때문이다. 이 외에도 산소 분 위기에서 가열을 하였을 때 oxygen vacancy의 감소로 인해 스트레스에 대한 안정성이 높아졌기 때문이다<sup>[26]</sup>.

## IV.결 론

총 5단계 공정을 적용해 솔루션 공정을 사용하여 IZO TFT를 제작하고 spin-coating 법을 사용해 SU-8 절연막을 IZO TFT 위에 증착하였다. 그리고 SU-8을 증착 후 가열을 하고, IZO TFT의 전기적인 특성 변화 의 이유를 알아보기 위해 XPS, FTIR 분석을 실시하였 다. SU-8을 증착한 직후에는 SU-8과 IZO 표면의 변화 에 의해 반도체적 성질을 띠지 않다가 한 번 가열을 한 후(4단계) V<sub>th</sub>는 -4.9V, 이동도는 8.24[cm<sup>2</sup>/V·s], Ion/off 비는 6\*10<sup>2</sup>로 증가하였고 다시 가열을 한 뒤(5단계)에는 더욱 V<sub>th</sub>가 7.2V로 양의 방향으로 이동하고 이동도는 6.43[cm<sup>2</sup>/V·s]로 감소하였으나 Ion/off비가 10<sup>6</sup>으로 더욱 증가하였다. 그리고 조밀해진 SU-8이 외부 산소와의 흡/탈착을 막고 가열로 인한 oxygen vacancy의 감소에 의해 3600초 동안 PBS를 가했을 때 ΔVth가 1단계의 7.7V에서 3.6V로 안정성이 증가함을 확인 할 수 있었 다. 이를 통해 진공공정으로 증착한 절연층에 비해 솔 루션 공정을 적용해 간단하면서도 이동도의 감소는 적 고 다른 전기적 특성은 향상된, 절연층을 증착한 TFT 소자를 제작할 수 있었다.

#### REFERENCES

- E. Fortunato, P. Barquinha and R. Martins, "Oxide Semiconductor Thin-Film Transistors: A Review of Recent Advances", *Advanced Materials*, vol. 24, no. 22, pp.2945–2986, 2012.
- [2] Dong Hyeok Choi, In-Bo Shim, Tae Joon Kouh, and Chul Sung Kim, "Microstructure of the Oriented Hexagonal HoMnO3 Thin Films by PLD", *Journal of Magnetics*, vol. 12, No. 4, pp.141–143, 2007.
- [3] Han Seo, Mi-Jung Ji, Yong-Tea An, Byeong-Kwon Ju, and Byung-Hyun Choi, "Effect of the Deposition Temperature on the Transmittance & Electrical Conductivity of Films  $In_{1.6}Zn_{0.2}Sn_{0.2}O_{3-\delta}$ Thin Prepared bv RF-magnetron Sputtering", Journal of the Korean Ceramic Society, Vol. 49, No. 6, pp.

663-668, 2012.

- [4] W. Jonathan .Hennek, Y Xia, E. Ken, C. Mark. Hersam, F. Antonio, and T. J. Marks, "Reduced Contact Resistance in Inkjet Printed High-Performance Amorphous Indium Gallium Zinc Oxide Transistors", *Appl. Mater and Interface*, vol 4. pp.1614–1619, 2012.
- [5] Y Wang, X W Sun, G.K.L. Goh,, H.V. Demir, YY Hong, "Influence of Channel Layer Thickness on the Electrical Performances of Inkjet-Printed In-Ga-Zn Oxide Thin-Film Transistors", *IEEE Transactions on Electron Devices*, vol. 58, pp.480-485, 2011.
- [6] G. H. Kim, H. S. Kim, H. S. Shin, B. D. Ahn, K. H. Kim, H. J. Kim, "Inkjet-printed InGaZnO thin film transistor", *Thin Solid Films*, vol. 517, pp. 4007–4010, 2009.
- [7] M. J. Yu, Y. H. Yeh, C. C. Cheng, C. Y. Lin, G. T. Ho, B.C.M Lai, ., C. M. Leu, T. H. Hou, , Y. J. Chan, "Amorphous InGaZnO thin-film transistors compatible with roll-to-roll fabrication at room temperature", *IEEE Electron Device Letters*, vol.33, pp.47-49, 2012.
- [8] D. H. Lee, Y. J. Chang, G. S. Herman and C. H. Chang, "A General Route to Printable High-Mobility Transparent Amorphous Oxide Semiconductors", *Adv. Mater*, vol. 19, pp.843–847, 2007.
- [9] J. H. Park, W. J. Choi, J. Y. Oh, S. S. Chae, W. S. Jang, J. Lee, S. Song K. M. Baik, H. Koo, "Low-Temperature, Aqueous-Solution Processed Zinc Tin Oxide Thin Film Transistor", *J. Appl Phys*, vol. 50, pp.070201, 2011.
- [10] J. H. Park, W. J. Choi, S. S. Chae, J. Y. Oh, J. Lee, S. Song, K. M. Baik, K. Hong, "Structural and Electrical Properties of Solution-Processed Gallium-Doped Indium Oxide Thin-Film Transistors", J. Appl. Phys, vol. 50, pp. 080202, 2011.
- [11] S., H. Jeong, Y. G, Moon, J, Facchetti, A., Marks, T. "Role of Gallium Doping in Dramatically Lowering Amorphous–Oxide Processing Temperatures for Solution–Derived Indium Zinc Oxide Thin–Film Transistors", Adv Mater, vol.22, pp.1346–1350, 2010.
- [12] D. H. Kang, H. Lim, C. J. Kim, I. H. Song, J. C. Park, and Y. S. Park, "Amorphous gallium indium zinc oxide thin film transistors: Sensitive to oxygen molecules", *Appl Phys Lett*, vol. 90,

pp.192101, 2007.

- [13] K. H. Lee, J. S. Jung, K. S. Son, J. S. Park, T. S. Kim, R. Choi, J. K. Jeong, J. Y. Kwon, B. W. Koo and S. Y. Lee, "The effect of moisture on the photon-enhanced negative bias thermal instability in Ga-In-Zn-O thin film transistors", *Appl Phys Lett*, vol. 95, pp.232106, 2009.
- [14] J. S. Park, J. K. Jeong, H. J. Chung , Y. G. Mo, H. D. Kim, "Electronic transport properties of amorphous indium-gallium-zinc oxide semiconductor upon exposure to water", *Appl Phys Lett*, vol. 92, pp.072104, 2008.
- [15] S. H. Choi, M. K. Han, "Effect of Deposition Temperature of SiOx Passivation Layer on the Electrical Performance of a-IGZO TFTs", *IEEE Electron Device Letters*, vol. 33, pp. 396–398, 2012.
- [16] H. S. Seo, J. U. Bae, D. H. Kim, Y. J. Park, C. D. Kim, I. B. Kang, I. J. Chung, J. H. Choi and J. M. Myoung, "Reliable Bottom Gate Amorphous Indium Gallium Zinc Oxide Thin-Film Transistors with TiOx Passivation Layer", *Solid-State Letters*, vol. 12, pp.H348-351, 2009.
- [17] T.Arai, N.Morosawa, K.Tokunaga, Y.Terai, E. Fukumoto, T.Nakayama, T. Yamaguchi, and T. Sasaoka, *SID Symposium Digest of Tech*, vol. 41, pp. 1033, 2010.
- [18] Y. Ko, S. Bang, S. Lee, S. Park, J. Park, and H. Jeon, "The effects of a HfO2 buffer layer on Al2O3-passivated indium-gallium-zinc-oxide thin film transistors", *physica status solidi (RRL) Rapid Research Letters*, vol. 5, pp.403–405, 2011.
- [19] A. Olziersky, P. Barquinha, A. Vila, L. Pereira, G. Goncalves, E. Fortunato, R. Martins, J. R. Morante, "Insight on the SU-8 resist as passivation layer for transparent Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ZnO thin-film transistors", *J. Appl. Phys*, vol. 108, pp.064505, 2010.
- [20] M. Egginger, S. Bauer, R. Schwödiauer, H. Neugebauer, N. S. Sariciftci, "Current versus gate voltage hysteresis in organic field effect transistors", *Monatshefte für Chemie – Chemical Monthly*, vol. 140, pp. 735–750, 2009.
- [21] M. E. Lopes, H. L. Gomes, M. C. R. Medeiros, P. Barquinha, L. Pereira, E. Fortunato, R. Martins and I. Ferreira, "Gate-bias stress in amorphous oxide semiconductors thin-film transistors", *Appl hys Lett*, vol. 95, pp.063502,

2009.

- [22] M. K. Gunde, N. Hauptman, M. Maček, M. Kunaver, "The influence of hard-baking temperature applied for SU8 sensor layer on the sensitivity of capacitive chemical sensor", *Appl. Phys. Lett*, vol. 95, pp.673–680, 2008.
- [23] J. K. Chen, F. H. Ko, H. K. Chen, C. T. Chou, H. L.Chen. and F. C. Chang, "Effect of fluoroalkyl substituents on the reactions of alkylchlorosilanes with mold surfaces for nanoimprint lithography", J. Vacuum Science & Technology B, vol. 22, pp.492, 2004.
- [24] K. H. Lee, J. H. Park, Y. B. Yoo, W. S. Jang, J. Y. Oh, S. S. Chae, K. J. Moon, J. M. Myoung, and H. K. Baik, "Effects of Solution Temperature on Solution-Processed. High-Performance Metal Oxide Thin-Film Transistors", *Appl materials & interfaces*, vol. 5, pp. 2585–2592, 2013.
- [25] E. Fortunato, P. Barquinha, A. Pimentel, A. Gonçalves, A. Marques, L. Pereira, R. Martins, "Recent advances in ZnO transparent thin film transistors", *Thin Solid Films*, vol. 487, pp.205–211, 2005.
- [26] J. P. Bermundo, Y. Ishikawa, H. Yamazaki, T. Nonaka and Y. Uraoka, "Highly Reliable Passivation Polysilsesquioxane Layer for a-InGaZnO Thin-Film Transistors", Ī. Solid Science Technology, State and vol. З, pp.Q16-Q19, 2013.



김 상 조(학생회원) 2011년 건국대학교 전자공학부 학사 졸업. 2015년 부산대학교 전자전기 컴퓨터공학과 석사 졸업.

<주관심분야 : 산화물반도체>

- 저 자 소 개 -



이 문 석(정회원) 1991년 포항공과대학교 전자전기 공학 학사 졸업 1995년 포항공과대학교 전자전기 공학 석사 졸업 1999년 포항공과대학교 전자전기 공학 박사 졸업

1999년~2002년 미국 로렌스버클리 연구소 Staff Scientist

2002년~2004년 삼성전자 책임연구원 2004년~현재 부산대학교 전자공학과 교수 <주관심분야 : 반도체소자, 공정, 나노패터닝, 산 화물반도체, 차세대 리쏘그래피통신>